Anlage zur FSPO vom 25.07.2018 für den Masterstudiengang Microelectronics and Microsystems an der TUHH

Studiengangsleiter/-in: Prof. Hoc Khiem Trieu

Gesamt: 120 LP

Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1



Studienplan Master Microelectronics and Microsystems (IMPMM)

Konsolidierte Fassung

für die Studienanfängerkohorte: WiSe18/19

gem. AS-Beschluss vom: 25.07.2018

und Präsidiumsgenehmigung vom: 22.08.2018

Inkrafttreten: 01.10.2018 Außerkrafttreten: 30.09.2021

Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.

	Modul						Prüfung			Studienleistung		
Empf.	Modulname (deutsch / englisch)	Sprache	Modul verantwortung	Institut	P/WP (1)	GM/	LP (4)	Note	Prüf ungs-	Ver pflichtend	Art	Bonus (in
Sem.						OM (2)			art(3)			%)
				'								
Kernqua	lifikation Pflichtbereich: 28 LP Wahlpflichtbereich: 44 LP											
1	CMOS-Nanoelektronik mit Praktikum / CMOS Nanoelectronics with Practice	EN	NN	E-9	WP	GM	6	J	KL	J	FFST	0
1	Elektronische Bauelemente und Schaltungen / Electronic Devices and Circuits	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	MP			
1	Mikrosystemtechnik / Microsystem Engineering	EN	Prof. Kasper	E-7	WP	GM	6	J	KL	N	RE	10
1	Mikrosystemtechnologie in Theorie und Praxis / Microsystems Technology in	EN	Prof. Trieu	E-7	WP	GM	6	J	MP	J	FFST	0
	Theory and Practice											
2	Grundlagen des IC-Entwurfes / Fundamentals of IC Design	DE / EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	MP			
2	Halbleiterseminar / Semiconductor Seminar	EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	2	J	RE			
2	Mikrosystementwurf / Microsystem Design	EN	Prof. Kasper	E-7	WP	GM	6	J	MP	J	SA	0
2	Seminar Informationstechnik / Seminar Communications Engineering	DE / EN	Prof. Bauch	E-8	WP	GM	2	J	RE	J	SA	0
2	Technischer Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich ET (laut FSPO) / Technical		Prof. Trieu	E-7	WP	ОМ	6 la	ut FSPO				
	Elective Complementary Course for IMPMM - field ET (according to Subject											
	Specific Regulations)											
2-3	Praktischer Schaltungsentwurf analog und digital / Laboratory: Analog and	DE	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	KL			
	Digital Circuit Design											
3	Projektarbeit IMPMM / Project Work IMPMM		NN	E-9	Р	GM	16	J	STA			

		Modul					Prüfung			Studienleistung					
Empf. Sem.	Modulname (deutsch / englisch)	Sprache	Modul verantwortung	Institut	P/WP (1)	GM/ OM (2)	LP (4) Note	Prüf ungs- art(3)	Ver pflichtend	Art	Bonus (ii			
3	Technischer Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich TUHH (laut FSPO) / Technical Elective Complementary Course for IMPMM - field TUHH (according to Subject Specific Regulations)		Prof. Trieu	E-7	WP	OM	6	laut FSPO							
1-3	Nichttechnische Ergänzungskurse im Master / Nontechnical Elective Complementary Courses for Master	DE / EN	Richter	0-TUHH	Р	ОМ	6	6 Auswahl aus seperat veröffentlichtem Katalog							
1-3	Betrieb & Management / Business & Management	DE / EN	Prof. Meyer	W-1	Р	ОМ	6	6 Auswahl aus seperat veröffentlichtem Katalog							
ertiefun	g Communication and Signal Processing Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtber	eich: 18 LP													
1	Hochfrequenztechnik / Microwave Engineering	DE / EN	Prof. Jacob	E-3	WP	GM	6	J	KL	J	FFST	0			
1	Kommunikationsnetze / Communication Networks	EN	Prof. Timm-Giel	E-4	WP	GM	6	J	RE						
2	Weiterführende Konzepte der drahtlosen Kommunikation / Advanced Concepts of Wireless Communications	EN	Dr. Grünheid	E-8	WP	GM	6	J	KL						
3	3D Computer Vision / 3D Computer Vision	EN	Prof. Grigat	E-2	WP	GM	6	J	KL						
3	Digitale Audiosignalverarbeitung / Digital Audio Signal Processing	EN	Prof. Zölzer	E-8	WP	GM	6	J	KL						
3	Digitale Bildanalyse / Digital Image Analysis	EN	Prof. Grigat	E-2	WP	GM	6	J	KL						
3	Digitale Signalverarbeitung und Digitale Filter / Digital Signal Processing and Digital Filters	EN	Prof. Bauch	E-8	WP	GM	6	J	KL						
ertiefun	g Embedded Systems Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP														
1	Rechnerarchitektur / Computer Architecture	DE / EN	Prof. Falk	E-13	WP	GM	6	J	KL	N	FFST	15			
2	Drahtlose Sensornetze / Wireless Sensor Networks	EN	Prof. Renner	E-EXK2	WP	GM	6	J	MP						
2	Eingebettete Systeme / Embedded Systems	EN	Prof. Falk	E-13	WP	GM	6	J	KL	J	FFST	10			
2	Entwurf von Dependable Systems / Design of Dependable Systems	DE / EN	Prof. Fey	E-13	WP	GM	6	J	MP	N	ÜA	0			
3	Fortgeschrittener Entwurf von Chip-Systemen (Praktikum) / Advanced System-on-Chip Design (Lab)	DE / EN	Prof. Falk	E-13	WP	GM	6	N	FFA						
ertiefun	g Microelectronics Complements Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 l	Р													
1	Medizinelektronik / Electronic Circuits for Medical Applications	EN EN	Prof. Kuhl	E-9	WP	GM	6	J	MP	N	FFST	0			
·	modelinostation / Electronic chodic let modela / pp.neatione		11011110111			G.III				N N	ÜA	20			
2	EMV I: Kopplungen, Gegenmaßnahmen und Prüfverfahren / EMC I: Coupling Mechanisms, Countermeasures and Test Procedures	DE / EN	Prof. Schuster	E-18	WP	GM	6	J	MP	J	RE	0			
2	Faseroptik und Integrierte Optik / Fibre and Integrated Optics	EN	Prof. Eich	E-12	WP	GM	4	J	KL						
2	Halbleitertechnologie / Semiconductor Technology	DE / EN	Prof. Trieu	E-7	WP	GM	6	J	MP						
2	Optoelektronik I - Wellenoptik / Optoelectronics I - Wave Optics	EN	Prof. Eich	E-12	WP	GM	4	J	KL						
3	EMV II: Signalintegrität und Spannungsversorgung elektronischer Systeme / EMC II: Signal Integrity and Power Supply of Electronic Systems	DE / EN	Prof. Schuster	E-18	WP	GM	6	J	MP	J	RE	0			
3	Optoelektronik II - Quantenoptik / Optoelectronics II - Quantum Optics	EN	Prof. Eich	E-12	WP	GM	4	J	KL						
3-4	Design von hochkomplexen integrierten Systemen und CAD-Werkzeuge / Design of Highly Complex Integrated Systems and CAD Tools	EN	Prof. Klinger	E-9	WP	GM	6	J	MP						

	Modul								Prüfung			Studienleistung		
	Empf.	Modulname (deutsch / englisch)	Sprache	Modul verantwortung	Institut	P/WP (1)	GM/	LP (4)	Note	Prüf ungs-	Ver pflichtend	Art	Bonus (in	
	Sem.						OM (2)			art(3)			%)	
Ab	Abschlussarbeit Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP													
	4	Masterarbeit / Master Thesis		Professoren der TUHH	0-TUHH	Р	GM	30	J	AB				

Legende:

Tegerfücht, WP=Wahlpflicht

GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul

RL=Klausur, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, STA=Studienarbeit, ÜA=Übungsaufgaben, AB=Abschlussarbeit

LP=Leistungspunkte

VL=Vorlesung, SE=Seminar, UE=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, HÜ=Hörsaalübung

DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch

SWS=Semesterwochenstunden